

有關本公司及附屬公司的進一步資料

註冊成立

本公司於2015年5月19日註冊成立，當時稱為合肥晶合集成電路有限公司。本公司於2020年11月25日改制為股份公司，名稱變更為合肥晶合集成電路股份有限公司，並於2023年5月5日在上海證券交易所科創板完成A股上市（證券代碼：688249.SH）。截至最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣2,007,591,697元，包括2,007,591,697股每股面值人民幣1.00元的A股。

本公司於香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。本公司已於2025年10月31日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。葉翠媚女士已獲委任為本公司授權代表，以於香港接收法律程序文件，其法律程序文件接收地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

由於本公司於中國成立，其運營須遵守中國相關法律及法規。有關中國法律及法規以及公司章程有關方面的概要分別載於本文件附錄四及附錄五。

本公司股本變動

於2025年12月30日，經董事會決議，本公司註冊資本由人民幣2,006,135,157元增加至人民幣2,007,591,697元。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無任何更改。

股東決議案

於2025年9月16日舉行的臨時股東會上，除其他事項外，下列決議案獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]獲行使前將予發行的H股數目不得超過[編纂]完成後([編纂]獲行使前)本公司經擴大股本的10%，以及授出[編纂]所涉及股份不超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及於香港聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的經修訂公司章程。

附屬公司的股本變動

公司資料概要及我們的附屬公司的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註37。

除下文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們附屬公司的註冊資本並無更改。

附錄六

法定及一般資料

合肥皖芯的註冊資本於2025年12月10日由人民幣9,588,553,835.52元增加至人民幣12,428,924,977.35元。

晶匯瑞盈(香港)有限公司於2025年9月3日在香港成立，註冊資本為10,000港元。

合肥晶匯瑞盈於2025年7月24日在中國成立，註冊資本為人民幣300,100,000元。

合肥皖芯的註冊資本於2024年5月11日由人民幣20,000,100元增加至人民幣50,000,100元，並進一步增加至2025年3月10日的人民幣9,588,553,835.52元。

有關我們業務的進一步資料

重大合同概要

以下為本集團成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立屬或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

(a) [編纂]。

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	權利持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
1...	晶合	中國	本公司	9	26295138A	2028年11月6日
2...	晶合	中國	本公司	25	26261189	2028年10月27日
3...	晶合	中國	本公司	35	26283543	2028年9月6日
4...	晶合	中國	本公司	40	26258453	2028年8月27日
5...	晶合集成	中國	本公司	9	26296982A	2028年11月6日
6...	晶合集成	中國	本公司	25	26257005	2028年10月27日
7...	晶合集成	中國	本公司	35	26279879	2028年9月6日
8...	晶合集成	中國	本公司	40	26258966	2028年8月27日
9...	Nexchip	中國	本公司	16	62617086	2032年8月13日
10..	Nexchip	中國	本公司	24	62615949	2032年8月13日
11..	Nexchip	中國	本公司	35	62618866	2032年8月13日
12..	Nexchip	中國	本公司	40	71472023	2033年11月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	權利持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
13..	晶合	中國	本公司	40	71443272	2033年11月27日
14..	晶合集成	中國	本公司	40	71468441	2033年11月27日
15..	晶合	日本	本公司	9	6050343	2028年6月7日
16..	晶合	日本	本公司	25	6070505	2028年8月9日
17..	晶合	日本	本公司	35	6050343	2028年6月7日
18..	晶合	日本	本公司	40	6070505	2028年8月9日
19..	晶合集成	日本	本公司	9	6050344	2028年6月7日
20..	晶合集成	日本	本公司	25	6071852	2028年8月16日
21..	晶合集成	日本	本公司	35	6050344	2028年6月7日
22..	晶合集成	日本	本公司	40	6071852	2028年8月16日
23..	晶合	中國台灣	本公司	9	01919637	2028年6月15日
24..	晶合	中國台灣	本公司	25	01909401	2028年4月15日
25..	晶合	中國台灣	本公司	35	01920981	2028年6月15日
26..	晶合	中國台灣	本公司	40	01912743	2028年4月30日
27..	晶合集成	中國台灣	本公司	9	01919636	2028年6月15日
28..	晶合集成	中國台灣	本公司	25	01909400	2028年4月15日
29..	晶合集成	中國台灣	本公司	35	01920980	2028年6月15日
30..	晶合集成	中國台灣	本公司	40	01918174	2028年5月31日
31..	晶合	美國	本公司	9	5523772	2028年7月23日
32..	晶合	美國	本公司	25	5518583	2028年7月16日
33..	晶合	美國	本公司	35	5513532	2028年7月9日
34..	晶合	美國	本公司	40	5518584	2028年7月16日
35..	晶合集成	美國	本公司	25	5518591	2028年7月16日
36..	晶合集成	美國	本公司	9	5523770	2028年7月23日
37..	晶合集成	美國	本公司	35	5523769	2028年7月23日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	權利持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
38 ..	晶合集成	美國	本公司	40	5513586	2028年7月9日
39 ..	Nexchip	英國	本公司	9	UK00003845814	2033年1月26日
40 ..	Nexchip	英國	本公司	25	UK00003845461	2033年1月26日
41 ..	Nexchip	英國	本公司	35	UK00003845464	2033年1月26日
42 ..	Nexchip	英國	本公司	40	UK00003845470	2033年1月26日
43 ..	Nexchip	澳大利亞	本公司	9	2312537	2032年11月3日
44 ..	Nexchip	澳大利亞	本公司	25	2312538	2032年11月3日
45 ..	Nexchip	澳大利亞	本公司	35	2312539	2032年11月3日
46 ..	Nexchip	澳大利亞	本公司	40	2312540	2032年11月3日
47 ..	Nexchip	泰國	本公司	40	231133019	2033年2月22日
48 ..	Nexchip	泰國	本公司	35	231133022	2033年2月22日
49 ..	Nexchip	泰國	本公司	25	231133049	2033年2月22日
50 ..	Nexchip	泰國	本公司	9	231133619	2033年2月22日
51 ..	Nexchip	加拿大	本公司	40	1341901	2035年8月21日
52 ..	Nexchip	加拿大	本公司	35	1341901	2035年8月21日
53 ..	Nexchip	加拿大	本公司	25	1341901	2035年8月21日
54 ..	Nexchip	加拿大	本公司	9	1341901	2035年8月21日

附錄六

法定及一般資料

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的著作權：

序號	著作權	著作權 擁有人	註冊編號	註冊日期
1	晶合Tapeout 流程自動化工具 軟件V1.0	本公司	2023SR0003023	2023年1月3日
2	晶合Tapeout 流程自動化工具 軟件V2.0	本公司	2023SR1080869	2023年9月15日
3	晶合Auto DRC自動化工具軟 件V1.0	本公司	2023SR0833969	2023年7月17日
4	晶合Linux服務器監控管理工 具軟件V1.0	本公司	2024SR1409282	2024年9月23日
5	晶合文件自動同步工具軟件 V1.0	本公司	2025SR0002286	2025年1月2日
6	晶合Tapeout 流程自動化工具 軟件V3.0	本公司	2025SR0002284	2025年1月2日
7	晶合Linux服務器及license 管理工具軟件V1.0	本公司	2025SR0086823	2025年1月14日
8	晶合VNC文件傳輸及 權限管控系統V1.0	本公司	2025SR2230406	2025年11月19日
9	晶合eShuttle任務自動化 服務工具軟件[簡稱 ShuttleRun] V1.0	本公司	2025SR2230378	2025年11月19日
10 . . .	晶合Tapeout 流程自動化 工具軟件[簡稱Auto Tapeout] V4.0	本公司	2025SR2230526	2025年11月19日
11 . . .	晶合自動化生成mark工具軟 件[簡稱CreateMark] V1.0	本公司	2025SR2230461	2025年11月19日
12 . . .	晶合Tapeout 流程自動化 工具軟件[簡稱Auto Tapeout] V5.0	本公司	2026SR0409974	2026年3月10日
13 . . .	晶合GDS類型文件管理工具 軟件[簡稱CAD_SVN] V1.0	本公司	2026SR0409887	2026年3月10日
14 . . .	晶合Auto Mask Data Preparation 工具軟件 [簡稱AMDP] V1.0	本公司	2026SR0409915	2026年3月10日

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
1....	一種亞分辨率輔助圖形的獲取方法	本公司	中國	2020110697686	2023年12月5日
2....	一種半導體結構及其製造方法	本公司	中國	2023117225694	2024年3月1日
3....	一種半導體結構的製作方法	本公司	中國	2023110616998	2023年11月28日
4....	半導體結構及其製備方法	合肥新晶	中國	2023113026649	2023年12月26日
5....	半導體器件及其製備方法	本公司	中國	202410472192X	2024年6月28日
6....	一種半導體結構及其製備方法	本公司	中國	2023111077576	2023年11月28日
7....	一種半導體結構的製作方法	本公司	中國	2023114020940	2024年3月1日
8....	一種晶圓的測試裝置及半導體機台	本公司	中國	202322456723X	2024年5月28日
9....	磷酸蝕刻液回收方法及蝕刻方法	本公司	中國	202311107559X	2023年12月8日
10...	一種圖像傳感器的製作方法	本公司	中國	2024101293501	2024年6月4日
11...	一種半導體器件及其製作方法	本公司	中國	2023114249945	2024年3月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
12...	降低HARP工藝中晶圓滑片風險的方法	本公司	中國	202311482724X	2024年2月9日
13...	光學臨近效應修正建模方法及裝置	本公司	中國	2023114537143	2024年1月30日
14...	光學鄰近修正方法及系統	本公司	中國	202311388432X	2024年2月20日
15...	光學鄰近修正方法、系統、計算機設備及介質	本公司	中國	2023113871974	2024年2月20日
16...	一種背照式圖像傳感器的半導體結構及其製作方法	本公司	中國	2023114124174	2024年3月1日
17...	一種半導體掩膜版及其製作方法	本公司	中國	2023117155437	2024年3月1日
18...	一種半導體集成器件及其製作方法	本公司	中國	2023110619835	2023年11月28日
19...	半導體結構及其製備方法	本公司	中國	2023114852519	2024年2月20日
20...	一種半導體晶圓的對位標記的擺放方法	本公司	中國	2024101014787	2024年5月7日
21...	NMOS晶體管製備方法及NMOS晶體管	本公司	中國	2023116969550	2024年4月9日
22...	一種半導體結構及其製造方法	本公司	中國	2023116941748	2024年3月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
23...	一種用於量測MOS管的導通電阻的電路結構和芯片	本公司	中國	2023236432464	2024年12月13日
24...	一種半導體結構的製作方法及動態調整系統	本公司	中國	2024111548511	2024年12月3日
25...	等離子增強型化學氣相沉積方法和裝置	本公司	中國	2023114767713	2024年7月9日
26...	一種OPC修正方法及OPC修正系統	本公司	中國	202410259333X	2024年6月7日
27...	半導體結構及其製備方法	本公司	中國	202410137875X	2024年5月17日
28...	一種OPC修正方法	本公司	中國	2024102593344	2024年5月28日
29...	一種半導體檢測版圖、版圖設計方法及版圖設計系統	本公司	中國	2025102727377	2025年6月13日
30...	半導體結構的製備方法、半導體結構	合肥新晶	中國	2024116623345	2025年2月28日
31...	半導體疊層結構的製造方法及半導體結構	本公司	中國	2023117891572	2024年4月9日
32...	半導體結構的製備方法、半導體結構	合肥新晶	中國	2024116623580	2025年2月28日
33...	關鍵尺寸的量測方法及量測結構	本公司	中國	2024103189998	2024年6月7日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
34...	一種可尋址測試電路	本公司	中國	202420365690X	2024年10月15日
35...	圖像傳感器的製作方法及 圖像傳感器	本公司	中國	2024100658804	2024年4月26日
36...	半導體測試結構及其製備 方法、測試器件	合肥新品	中國	2024116622802	2025年3月25日
37...	晶體管測試方法及存儲器 監控方法	本公司	中國	2024104391188	2024年7月5日
38...	半導體結構及其製備方法	本公司	中國	2024103538471	2024年6月11日
39...	一種靜態隨機存取存儲器的 失效分析方法	本公司	中國	2024111787480	2024年12月24日
40...	虛電路生成裝置及其方法、 設備、存儲介質、程序產 品	本公司	中國	2024110899101	2024年12月27日
41...	淺溝槽隔離結構、半導體結 構及製備方法	本公司	中國	2024101910686	2024年5月28日
42...	背照式半導體結構鍵合方法 及背照式圖像傳感器	本公司	中國	2024118341131	2025年3月25日
43...	一種半導體結構的製作方法	本公司	中國	2024107028069	2024年8月13日
44...	電阻值的測量設備及測量 方法	本公司	中國	2024118453809	2025年3月18日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
45...	一種半導體測試結構的擺放方法、裝置、設備及介質	本公司	中國	2025102289476	2025年6月3日
46...	一種OPC建模方法、系統及計算機可讀存儲介質	本公司	中國	2025101278597	2025年4月25日
47...	半導體柵極結構的製備方法及半導體結構	本公司、 北京晶 芯成	中國	2024115556339	2025年3月18日
48...	一種半導體器件的形成方法	本公司	中國	2025101798267	2025年5月9日
49...	管控芯片版圖的方法、電子設備及計算機可讀存儲介質	本公司、 北京晶 芯成	中國	202411555631X	2025年3月14日
50...	半導體器件及其製備方法	本公司	中國	2025101062732	2025年4月25日
51...	一種LDMOS器件的製備方法、LDMOS器件	本公司	中國	2025100013226	2025年4月25日
52...	薄膜及其製備方法	本公司	中國	2025103098550	2025年6月27日
53...	半導體器件及製備方法	本公司	中國	2025101698485	2025年5月27日
54...	像素傳感器及其製備方法	本公司	中國	2025102010256	2025年6月27日
55...	半導體量測結構	本公司	中國	2025101623366	2025年4月25日
56...	晶圓刻蝕系統的控制方法、裝置、計算機設備和系統	本公司	中國	2025102131138	2025年6月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
57...	一種掩模版的圖形校正方法及校正系統	本公司	中國	202510947122.X	2025年9月9日
58...	半導體器件的製備方法	本公司、 北京晶 芯成	中國	202510603588.8	2025年9月16日
59...	半導體器件的仿真評價方法	本公司	中國	2025106086894	2025年7月18日
60...	一種半導體器件及其製造方法	本公司、 北京晶 芯成	中國	202510782771.9	2025年8月19日
61...	混合鍵合結構的製備方法及半導體器件	本公司	中國	2025103330035	2025年7月18日
62...	生產機台的參數收值設定方法、系統、計算機設備	本公司	中國	202510891063.9	2025年9月26日
63...	生產機台的工作參數異常檢測方法、裝置、計算機設備	本公司	中國	202510828941.2	2025年9月26日
64...	半導體結構的製備方法及半導體結構	本公司	中國	2025102570277	2025年7月15日
65...	用於半導體製造工廠的產品品質監控方法及監控系統	本公司、 北京晶 芯成	中國	2025101301061	2025年7月4日
66...	晶圓盒檢測設備及晶圓盒系統	本公司	中國	2024228195870	2025年9月26日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利權人	註冊地點	專利號	授出公告日期
67...	一種光學鄰近校正模型的建模方法、系統及計算機設備	本公司	中國	202510803572.1	2025年8月19日

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	nexchip.com.cn	本公司	2029年9月16日

除上文所述外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大的商標或服務標記、專利、知識產權或工業產權。

有關董事及高級管理層的進一步資料

服務合同詳情

我們已與各董事訂立合同，其中內容有關(i)遵守相關法律及法規；(ii)遵從公司章程；及(iii)仲裁條款。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂有任何服務合同(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同)。

董事薪酬

董事以薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支及退休金計劃供款的形式收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支及退休金計劃供款)分別約為人民幣8.34百萬元、人民幣8.43百萬元及人民幣10.25百萬元。

權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，亦無根據限制性股票激勵計劃發行新股份，且本公司的已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]概無其他變動)，董事及最高行政人員將於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及/或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文其被

附錄六

法定及一般資料

當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉如下：

於股份的權益

姓名	職位	權益性質 ⁽¹⁾	股份數目 及說明	[編纂]完成後的 股權概約百分比(%) ⁽²⁾	
				於A股	於本公司 已發行 股本總額
蔡國智先生.....	執行董事兼董事長	實益擁有人	1,773,543 ⁽³⁾ 股 A股	[編纂]	[編纂]
朱才偉先生.....	執行董事、董事會秘書、 財務負責人 兼副總經理	實益擁有人	1,360,931 ⁽³⁾ 股 A股	[編纂]	[編纂]
邱文生先生 ⁽⁴⁾	非執行董事	受控法團權益	120,368,109股 A股	[編纂]	[編纂]
邱顯寰先生.....	聯席總經理	實益擁有人	1,300,000 ⁽³⁾ 股 A股	[編纂]	[編纂]
鄭志成博士.....	聯席總經理	實益擁有人	2,038,334 ⁽³⁾ 股 A股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所有權益均為好倉。
- (2) 基於假設[編纂]未獲行使、並無根據限制性股票激勵計劃發行新股份且本公司的已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]概無其他變動計算得出。
- (3) 倘及待蔡國智先生、朱才偉先生、邱顯寰先生及鄭志成博士根據限制性股票激勵計劃獲授的限制性股票歸屬後，彼等在該計劃所定條件(包括歸屬條件)的規限下，各自有權分別收取最多1,700,000股A股、1,100,000股A股、1,300,000股A股及1,933,334股A股。
- (4) 截至最後實際可行日期，邱文生直接及透過其控制實體間接控制華勤技術股份有限公司股東會三分之一以上的投票權，根據證券及期貨條例，其會被當作於華勤技術股份有限公司所持全部股份中擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無董事或本公司最高行政人員將於本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文其被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述的登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

主要股東

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉的人士的資料，見本文件「主要股東」一節。

除本文件所披露者外，董事並不知悉，於緊隨[編纂]完成(包括因[編纂]發行任何額外H股)後，任何其他人士將於股份或本公司相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的任何權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本集團股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

限制性股票激勵計劃

以下為股東分別於2023年8月31日及2025年5月28日批准的2023年限制性股票激勵計劃及2025年限制性股票激勵計劃(統稱「限制性股票激勵計劃」或「計劃」)的主要條款概要。由於限制性股票激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出任何獎勵，故其條款不受上市規則第十七章的條文所規限。除另有披露者外，限制性股票激勵計劃的條款大致類似，概述如下。

(i) 目的

限制性股票激勵計劃的目的為完善本集團治理結構，建立長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和本公司核心競爭力，促進本公司戰略及經營目標的實現，在保障股東利益的前提下，制定本計劃。

(ii) 管理

董事會根據股東的授權執行限制性股票激勵計劃。薪酬與考核委員會負責擬定及修訂限制性股票激勵計劃條款，並提呈董事會審議及批准。

附錄六

法定及一般資料

(iii) 資格及參與

2023年限制性股票激勵計劃的參與者將包括本集團的管理層及核心員工。2025年限制性股票激勵計劃的參與者將包括董事(不包括獨立非執行董事)、本集團管理層及董事會不時釐定根據計劃接受獎勵的核心員工。

(iv) 股份來源及數目上限

2023年限制性股票激勵計劃相關股份應為本公司向參與者發行的新A股。2025年限制性股票激勵計劃相關股份應為本公司從二級市場購買的A股及/或本公司向參與者發行的新A股。授予的每股限制性股份代表於約定期限內按授予價格購買1股A股的權利。相關A股將於滿足規定歸屬條件後分批歸屬。2023年限制性股票激勵計劃項下可授出的限制性股份數目上限為20,061,351股，而2025年限制性股票激勵計劃項下可授出的限制性股份數目上限為62,088,500股。

(v) 授出日期及計劃期限

限制性股份的授出日期由董事會決定。公司須在股東會審議通過限制性股票激勵計劃後60日內按相關規定召開董事會向激勵對象首次授予限制性股票並完成公告等相關程序。限制性股票激勵計劃應於根據計劃授出限制性股份完成之日起生效，直至根據計劃授出的限制性股份悉數歸屬或作廢之日止，惟計劃的期限不得超過72個月。

(vi) 業績目標及歸屬

根據2023年限制性股票激勵計劃，視乎公司層面及參與者層面業績目標的達成情況，參與者持有的限制性股份應分別於首次授予限制性股份之日起計24個月、36個月及48個月分三期歸屬，每期歸屬三分之一。

根據2025年限制性股票激勵計劃，視乎公司層面及參與者層面業績目標的達成情況，參與者持有的限制性股份應分別於首次授予限制性股份之日起計24個月、36個月及48個月按33%、33%及34%的比例分三期歸屬。

倘承授人為董事或本公司高級管理層，其在任期屆滿前離職，於原本僱傭期間每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%。該董事或高級管理層在離職後6個月內不得轉讓其所持股份。如承授人為董事或本公司高級管理層，其在股份買入後6個月內賣出或在股份賣出後6個月內買入所得的收入應歸本公司所有，且將由董事會沒收。倘有關上述禁售規定的適用法律及法規有任何變動，承授人須遵守經修訂的法律及法規。

附錄六

法定及一般資料

(vii) 發行在外的限制性股份

截至最後實際可行日期，2023年限制性股票激勵計劃相關限制性股份總數為12,155,613股，佔最後實際可行日期本公司已發行股本約0.61%及緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使、並無根據限制性股票激勵計劃發行新股份及我們的已發行及發行在外股份於最後實際可行日期至[編纂]概無變動)本公司已發行股本總額約[編纂]。

截至最後實際可行日期，2025年限制性股票激勵計劃相關限制性股份總數為62,088,500股，佔最後實際可行日期本公司已發行股本約3.09%及緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使、概無根據限制性股票激勵計劃發行任何新股份及我們的已發行及發行在外股份於最後實際可行日期至[編纂]概無變動)本公司已發行股本總額約[編纂]。

假設根據限制性股票激勵計劃授予的所有發行在外限制性股份將透過發行新股份獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使及我們的已發行及發行在外股份於最後實際可行日期至[編纂]概無變動)，股東的股權將被稀釋約[編纂]%，而對每股收益的稀釋效應約為[編纂]%。

下表載列截至最後實際可行日期根據限制性股票激勵計劃授予董事及本公司高級管理層的發行在外限制性股份數目：

名稱	於本集團所擔任的職位	授予日	授予價格 (人民幣元) ⁽²⁾	已授出的 限制性 股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後 本公司經擴大 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
蔡國智先生.....	執行董事兼董事長	2025年6月26日	12.0	1,700,000	[編纂]
朱才偉先生.....	執行董事、董事會秘書、 財務負責人兼副總經理	2025年6月26日	12.0	1,100,000	[編纂]
邱顯寰先生.....	聯席總經理	2025年6月26日	12.0	1,300,000	[編纂]
鄭志成博士.....	聯席總經理	2023年10月23日 2025年6月26日	9.97 12.0	633,334 1,300,000	[編纂] [編纂]
朱曉娟女士.....	副總經理	2025年6月26日	12.0	1,100,000	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

名稱	於本集團 所擔任的職位	授予日	授予價格 (人民幣元) ⁽²⁾	已授出的 限制性 股份數目	估緊隨[編纂] 完成後
					本公司經擴大 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
周義亮先生.....	副總經理	2025年6月26日	12.0	1,100,000	[編纂]

附註：

- (1) 計算基於假設[編纂]未獲行使、概無根據限制性股票激勵計劃發行新股份及於最後實際可行日期至[編纂]並無對本公司已發行股本作出其他變動。
- (2) 根據日期為2025年6月26日的董事會決議案，由於分派股利，2023年限制性股票激勵計劃及2025年限制性股票激勵計劃各自項下的授予價格分別調整為每股人民幣9.97元及人民幣12.00元。

下表載列截至最後實際可行日期根據限制性股票激勵計劃授予其他承授人(不包括董事及本公司高級管理層)的發行在外限制性股份的詳情：

限制性股票激勵計劃	承授人 數量	授予日	授予價格 (人民幣元) ⁽¹⁾	已授出 限制性 股份數目	估緊隨[編纂] 完成後
					本公司經擴大 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
2023年限制性股票 激勵計劃 ⁽¹⁾	340	2023年10月23日及 2024年5月31日	9.97	11,522,279	[編纂]
2025年限制性股票 激勵計劃 ⁽¹⁾⁽³⁾	1,047	2025年6月26日及 2025年10月29日	12.0	54,488,500	[編纂]

附註：

- (1) 基於假設[編纂]未獲行使、概無根據限制性股票激勵計劃發行新股份及於最後實際可行日期至[編纂]並無對本公司已發行股本作出其他變動計算得出。
- (2) 根據日期為2025年6月26日的董事會決議案，(i)鑒於我們2024年的股利分派，2023年限制性股票激勵計劃項下的授予價格調整為每股人民幣9.97元，而2025年限制性股票激勵計劃項下的授予價格則調整為每股人民幣12.00元；及(ii)由於參與者變動，獲授予參與者人數調整為993名。
- (3) 根據日期為2025年10月29日的董事會決議案：(i)因離職等原因，2023年限制性股票激勵計劃項下61名個人已自參與者中移除，其先前已獲授的限制性股份相應被作廢；及(ii)在2025年限制性股票激勵計劃項下，新增的60名個人作為預留參與者獲授予額外2,700,000股限制性股份。

附錄六

法定及一般資料

免責聲明

- (a) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，概無董事或下文「其他資料－專家資格及同意書」提述的任何專家於本集團任何成員公司的發起中或於緊接本文件日期前兩年內在本集團任何成員公司所收購或出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (b) 除有關[編纂]外，概無董事或下文「其他資料－專家資格及同意書」提述的任何專家於本文件日期存續且對本集團業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。
- (c) 於緊接本文件日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、配發或提供現金、證券或其他利益，亦無意根據[編纂]或所述關聯交易支付、配發或提供任何有關現金、證券或利益。
- (d) 除「業務」一節所披露者外，概無董事或其緊密聯繫人(定義見上市規則)或現有股東(據董事所知，擁有已發行股本5%以上)於本集團任何五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本集團不大可能承擔重大遺產稅責任。

訴訟

就董事所知，本集團任何成員公司並無待決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)[編纂]及[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們同意向獨家保薦人支付合共3,000,000港元，作為擔任本公司有關建議於香港聯交所[編纂]的保薦人的費用。

專家資格及同意書

以下專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按照本文件所載的形式及內容轉載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)及提述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

附錄六

法定及一般資料

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
容誠(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
金杜律師事務所	美國出口管制及制裁法律顧問

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本公司或任何附屬公司擁有任何股權，亦無可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令所有有關人士受公司條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

雙語文件

本文件的英文及中文版本依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。

發起人

本公司的發起人為合肥建投、合肥芯屏、力晶科技股份有限公司、美的創新投資有限公司、合肥中安智芯股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳市惠友豪創投資合夥企業(有限合夥)、合肥存鑫集成電路投資合夥企業(有限合夥)、海通創新證券投資有限公司、杭州承富投資管理合夥企業(有限合夥)、瀘州隆信投資合夥企業(有限合夥)、寧波華淳投資管理合夥企業(有限合夥)、中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)、安徽安華創新風險投資基金有限公司、北京集創北方科技股份有限公司、中金浦成投資有限公司、合肥晶煨企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶遂企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶炯企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶咖企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶珏企業管理合夥企業(有限合夥)、

附錄六

法定及一般資料

合肥晶梢企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶柔企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶懇企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶本企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶洛企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶遼企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶確企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶鐵企業管理合夥企業(有限合夥)、合肥晶妥企業管理合夥企業(有限合夥)及合肥晶雄企業管理合夥企業(有限合夥)。

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述關聯交易向名列上文的發起人支付、配發或提供或建議支付、配發或提供任何現金、證券或利益。

開辦費用

就上市規則而言，本公司並未產生任何重大開辦費用。

無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，我們的財務或經營狀況並無重大變動。

其他事項

除本文件「歷史、發展及公司架構」、「財務資料」及本節所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 本公司或我們的任何附屬公司並無發行或同意發行或建議發行任何股份或貸款資本或債權證，以換取現金或任何以現金以外的其他方式繳足或未繳足的股份或貸款資本或債權證；
 - (ii) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或貸款資本並無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；及
 - (iii) 並無就發行或出售本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或貸款資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (b) 本公司或我們的任何附屬公司概無創始人、管理層或遞延股份或任何債權證；
- (c) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或貸款資本或債權證並無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；及
- (d) 本公司並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或貸款資本以認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司或我們的任何附屬公司的任何股份或債權證，而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

附錄六

法定及一般資料

- (e) 董事或名列本文件的專家並無在緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司所收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。除本文件所披露者外，本集團旗下任何公司現時並無在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣的股本或債務證券，亦無尋求或擬尋求批准股本或債務證券上市或買賣。
- (f) 本公司並無未轉換的可轉換債務證券或債權證。
- (g) 並無放棄或同意放棄未來股利的安排。
- (h) 於本文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響。